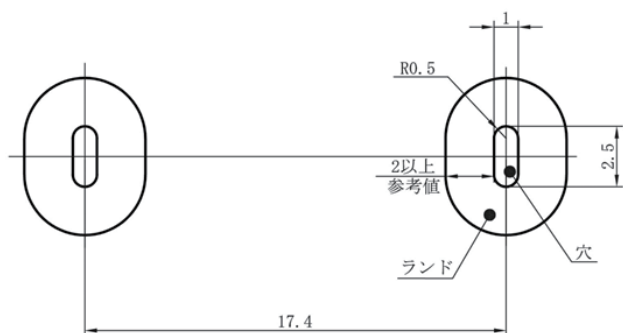


500SFKシリーズヒューズ基板取付設計資料

1. 推奨取付穴ピッチ



2. ヒューズ温度上昇

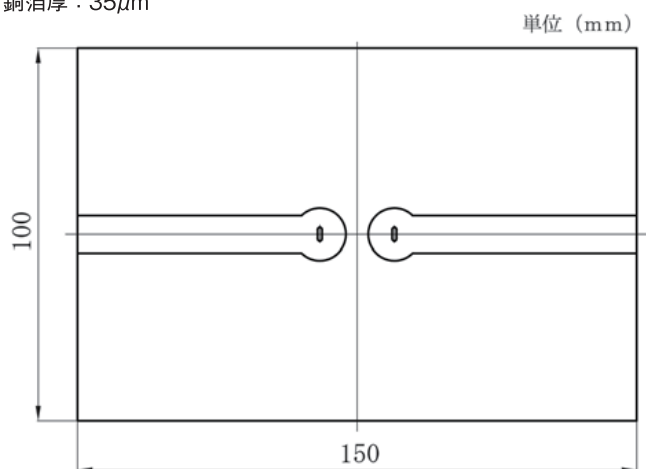
ヒューズの温度はパターン幅、通電電流等により大きく変わります。以下にヒューズ定格電流の50%の電流通電時に1A/mm(35 μ m銅箔厚)となるパターンによる温度上昇特性を提示いたしますのでパターン設計の参考として下さい。

●条件

基板サイズ：150mm×100mm

基板材質：FR-4

銅箔厚：35 μ m



●温度上昇特性

